



RE224-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 48 x 35 nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Conector D-Sub DIN 41652 2 x 9 polos y 2 x 15 polos
- 2 vías de potencial
- Tamaño 100 x 160 mm